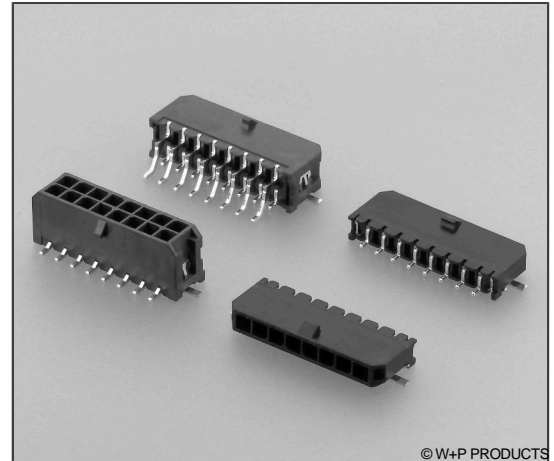


SMT-Crimp-Rast-Stiftleisten RM 3,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig SMT Friction Lock Headers, 3.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

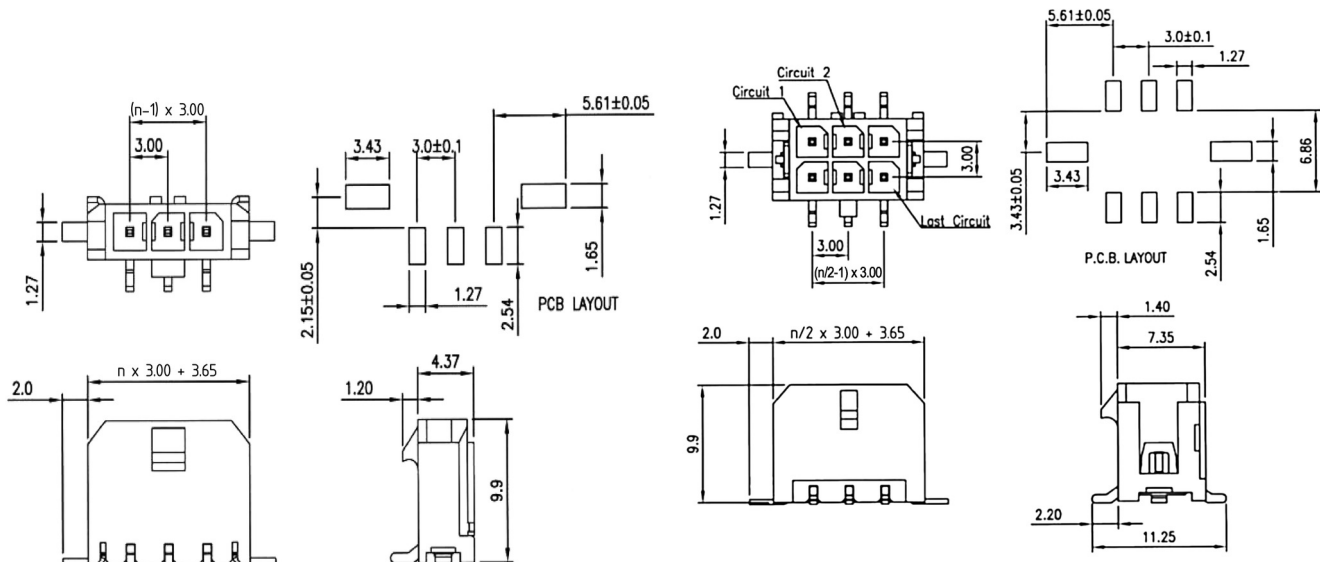
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung, Vierkantstift 0.64mm
Contact Material	Copper alloy, 0.64mm square pin
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5 kV AC
Test Voltage	1.5 kV AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	5 A
Current Rating	5 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

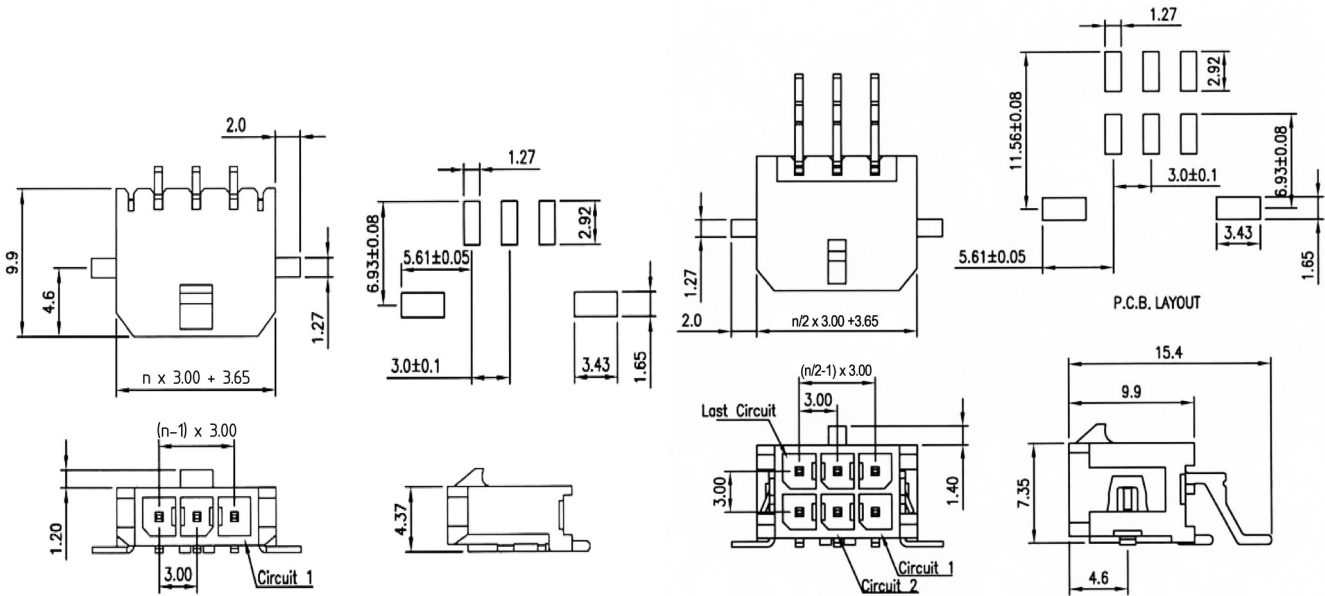
583



Series	Contacts*	Type	Plating	Packaging*
5830	06	2	50	PPTR
	02-12 Einreihig Single row 02-24 Zweireihig Double row	1 Einreihig stehend Single row, vertical 2 Zweireihig stehend Double row, vertical	50 Verzinkt Tin plated	TR PPTR

5830

SMT-Crimp-Rast-Stiftleisten RM 3,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig
 SMT Friction Lock Headers, 3.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, Single/Double Row



Series	Contacts*	Type*	Plating	Packing*
5830	12 02-12 Einreihig Single row 02-24 Zweireihig Double row	3 3 Einreihig liegend Single row, horizontal 4 Zweireihig liegend Double row, horizontal	50 50 Verzinnt Tin plated	PPTR TR PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

TR Tape & Reel ohne PP-Pads (Option) / Tape & Reel ohne PP-Pads (Option)
 PPTR Tape & Reel mit PP-Pads (Option) / Tape & Reel with PP-Pads (Option)

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

